



Laser marking



System laserového značenia a gravírovania
s pikosekundovým laserovým zdrojom

Systema di marcatura e incisione laser con sorgente laser al picosecondo

BSP PICO

Pikosekundový laserový zdroj : Sorgente laser al picosecondo

Tento typ zdroja generuje impulzy trvajúce len niekoľko pikosekúnd s intenzitou špičky takou vysokou, že dochádza k nelineárnej/ multifotónovej absorpcii: výsledkom je proces s veľmi zníženým tepelným účinkom, ktorý je ideálny na vykonávanie presného, plynulého a čistého značenia bez potreby opätovného opracovania kusov..

Kompaktný systém

BSP PICO má kompaktnú a pevnú konštrukciu vďaka žulovej pracovnej rovine, ktorá zaručuje vynikajúcu stabilitu procesu pri kusoch s hmotnosťou do 20 kg. Základná konštrukcia obsahuje 3 motorizované osi s presnosťou pohybu 50 µm, zdvih na rovine 300 x 300 mm a amplitúdu pozdĺž osi Z 360 mm..

Pokročilý software

Integrovaný softvér, ktorý kompletne vyvinula spoločnosť SISMA, je ideálnym riešením na správu súborov a celého procesu označovania, a to aj v prípade zložitých úloh: umožňuje plne využiť všetky BSP PICO, zaručuje vysoký stupeň prispôsobenia zrýchlenie a zjednodušenie práce operátora.

Questo tipo di sorgente genera impulsi della durata di pochi picosecondi con intensità di picco così elevate da dare luogo a un assorbimento non lineare/multifotone: ne risulta un processo dall'effetto termico molto ridotto, ideale per realizzare marcature precise, fluide e pulite senza la necessità di rilavorare i pezzi.

Sistema compatto

BSP PICO presenta una struttura compatta e solida grazie al piano di lavoro in granito, che garantisce un'ottima stabilità di processo e una tenuta fino ai 20 kg di peso. La struttura base include 3 assi motorizzati con precisione di movimento di 50 µm, corsa sul piano di 300 x 300 mm e un'ampiezza lungo l'asse Z che raggiunge i 360 mm.

Software avanzato

Interamente sviluppato da SISMA, il software integrato è la soluzione ideale per la gestione dei file e del processo di marcatura, anche nel caso di lavorazioni complesse: permettendo di sfruttare appieno le potenzialità di BSP PICO, garantisce un alto grado di personalizzazione per velocizzare e semplificare il lavoro dell'operatore.



Technické údaje - Dati tecnici

Active material - Materiale attivo	Yb
Priemerný výkon - Potenza di uscita	50 W
Vlnová dĺžka - Lunghezza d'onda	1030 nm
Pracovná frekvencia - Frequenza di lavoro	50 ± 2000 kHz
Trvanie impulzu - Durata impulso	0,001 - 0,003 ns
maximálny výkon - Potenza dipicco	10000 kW
Energia impulzu - Energia di impulso	0,025 mJ
Kvalita lúča - Qualità del fascio (M ²)	< 1,4
Chladiaci systém - Raffreddamento	water (on the base) / acqua (sul basamento)
Zdvih osi (XYZ) - Corsa assi (XYZ)	300 mm x 300 mm x 360 mm
Max hmotnosť kusu - Peso maxpezzo	20 kg
Presnosť osi - Precisione assi	0,05 mm
Opakovateľnosť osi - Ripetibilità assi	0,02 mm
Zdroj napájania - Alimentazione	230 V ± 15% 50/60 Hz - single phase - CEE 16A socket / presa
Absorpcia výkonu - Potenza assorbita	1 kW
Rozmery (D x H x Š) - Dimensioni (L x P x A)	823 mm x 1329 mm x h 1904 mm (h 2400 mm with open door - con porta aperta)
Hmotnosť - Peso	590 k

Funckie, obrázky, výkony, hmotnosti a miery uvedené v katalógu sú úplne orientačné a približné a môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Le caratteristiche, le immagini, le prestazioni, i pesi e le misure indicate si intendono del tutto indicativi ed approssimativi e possono variare senza preavviso.

10-2020